

5120825-1 ✕ VERALTET

Z-PACK | Z-PACK 2mm HM

Interne TE-Nummer 5120825-1

TE-interne Beschreibung: 2MMHM HDR ASY,12R SEL/LD 72P R

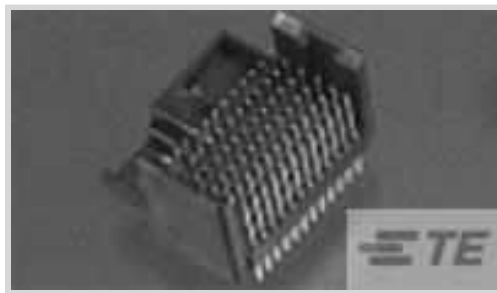
Harte metrische Steckverbinder (Stecker): Herkömmliche Backplane-Steckverbinder, Mezzanine, 2 mm

[Auf TE.com ansehen>](#)



[Steckverbinder](#) > [PCB-Steckverbinder](#) > [Backplane-Steckverbinder](#) > [Harte metrische Backplane-Steckverbinder](#) >

Harte metrische Steckverbinder (Stecker): Herkömmliche Backplane-Steckverbinder, Mezzanine, 2 mm



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Datenrate: **≤1 Gb/s**

Spaltenanzahl: **6**

Zeilenanzahl: **12**

Backplane-Architektur: **Mezzanine**

[Alle Harte metrische Steckverbinder \(Stecker\): Herkömmliche Backplane-Steckverbinder, Mezzanine, 2 mm \(124\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Backplane-Schnittstellentyp	2 mm HM
PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Bestückte Zeilen	Voll bestückt
Spaltenanzahl	6
Zeilenanzahl	12
Backplane-Architektur	Mezzanine
Anzahl von Positionen	72
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal

### Signalmerkmale

Übersprechversion	Standard
Datenrate	≤1 Gb/s

### Kontaktmerkmale

Durchführungspostenlänge	16 mm
Kontakttyp	Stift
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
CompactPCI-Bezeichnung	Keine
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	1.27 µm[50 µin]
Kontakt-nennstrom (max.)	.7 A

#### Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Press-Fit
-------------------------------------	-------------------------------

#### Montage und Anschlussstechnik

Fordere Steckebene	Ebene 2
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

#### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Polyester – GF
Raster	2 mm[.078 in]
Gehäusefarbe	Naturbelassen

#### Abmessungen

Backplane Modullänge	20.3 mm
----------------------	---------

#### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

#### Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
Stromkreis Anwendung	Signal

#### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt	Nein

#### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	27
Verpackungsmethode	Tube

## Weitere

Kommentar

Linksseitig

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233)  
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2021 (211)  
Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl &gt; 900 ppm.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Auch serienmäßig | Z-PACK 2mm HM



Abdeckungen für Leiterplatten-Steckverbinder(4)



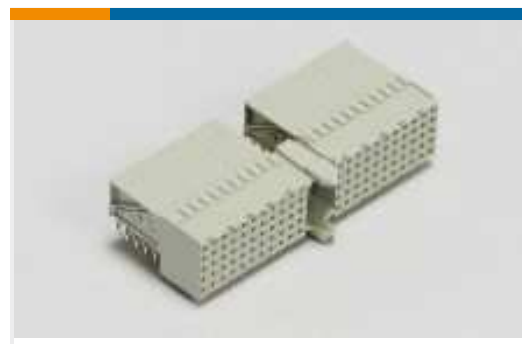
Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(39)



Backplane-Steckverbinder für Stromversorgung(6)



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (2)



Harte metrische Backplane-Steckverbinder(268)



Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder(1)



Kodierstücke für Backplanes(60)



Komponenten für Backplaneführungen (37)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(1)



Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(2)



Leiterplattenhülsen und -abschirmungen(19)



Rechteckige Leistungssteckverbinder (87)



Steckverbindergehäuse für Backplanes (4)

## Kunden kauften auch diese Produkte



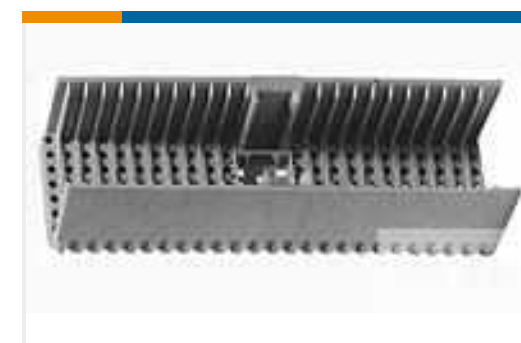
TE Teilnr.:T1425240000-000  
H24B-AG-BO-EMC



TE Teilnr.:YDTS20W21-41BNV001  
RECP ASSY



TE Teilnr.:5120823-1  
Harte metrische Steckverbinder  
(Stecker): Herkömmliche Backplane-  
Steckverbinder, Mezzanine, 2 mm



TE Teilnr.:120645-3  
2MM HM SHROUD HSG 144P 3.00 H

## Dokumente

### CAD-Dateien

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5120825-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5120825-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)



Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5120825-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

**Produktspezifikationen**

**Anwendungsspezifikation**

Englisch